

## PRESSEINFORMATION

### Erste IO-Link-Logikverteiler von IPF

#### Viele Freiheiten bei der Parametrierung

ipf electronic stellt erstmals die Logikmodule VL610304 und VL610308 mit vier bzw. acht Sensoreingängen vor, die aufgrund der IO-Link-Schnittstelle völlig frei und damit sehr flexibel parametrierbar sind.

Logikmodule verknüpfen verschiedene Sensorsignale logisch miteinander (UND-Verknüpfung bzw. ODER-Verknüpfung). Dies ist immer dann sinnvoll, wenn bspw. an Maschinen die digitalen Signale sehr vieler Sensoren zu verarbeiten sind, aber hierzu an einer Steuerung nicht genügend Eingänge zur Verfügung stehen. Bislang waren für verschiedene logische Verknüpfungen jedoch immer mehrere unterschiedliche Logikverteiler erforderlich, da sie unabhängig von der Anzahl der Steckplätze für die Sensorik (Eingänge) jeweils zwei Ausgänge haben. Im Auslieferungszustand lassen sich die Eingangssignale an den Ausgängen entweder nur UND- oder nur ODER-verknüpfen. Die Wahl der Logik und der damit verbundenen Aufgaben war somit bisher immer eingeschränkt.

Dank IO-Link können die neuen Logikmodule von ipf electronic indes sehr flexibel auf die jeweiligen Anforderungen hin parametrierbar werden. Das Ergebnis: Die Vielfalt der ansonsten für verschiedenste Verknüpfungsaufgaben erforderlichen Varianten reduziert sich drastisch. So lassen sich die Eingänge der Module nun unabhängig voneinander verknüpfen, wodurch ein einziger Verteiler sowohl die freie Wahl der Eingänge als auch der hierfür gewünschten Logiken ermöglicht.

Eine interessante Funktion ist zudem die Einrichtung von virtuellen Gruppen mit einem einzigen Logikmodul. So lassen sich bspw. bestimmte Steckplätze mit einer virtuellen UND-Verknüpfung in einer Gruppe zusammenfassen, während die übrigen Steckplätze in einer zweiten virtuellen Gruppe miteinander ODER-verknüpft werden. Die jeweiligen Ausgänge der Gruppen führen dann auf eine weitere gemeinsame und ebenfalls frei wählbare Logik. Für derartige Konfigurationen sind bislang drei herkömmliche Logikverteiler notwendig.

Darüber hinaus bieten die neuen Logikmodule weitere Vorteile, die u.a. bereits von IO-Link-Sensoren bekannt sind. Hierzu gehört u.a. der schnelle und sichere Gerätewechsel bei einem Defekt, da der IO-Link-Master die bereits hinterlegten Parameter eines defekten Gerätes automatisch auf das Austauschmodul übertragen kann.

Die neuen IO-Link-Logikmodule überzeugen durch höhere Einsatzflexibilität in der Praxis, minimieren maßgeblich den Verdrahtungsaufwand, reduzieren die Lagerhaltung und sparen Platz bei der Montage.



**Bildunterschrift:** Mehr Möglichkeiten trotz geringerer Variantenvielfalt: die neuen Logikmodule von ipf electronic mit IO-Link-Schnittstelle. (Bild: ipf electronic gmbh)